

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年5月6日(2010.5.6)

【公開番号】特開2008-160156(P2008-160156A)

【公開日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-027

【出願番号】特願2008-73717(P2008-73717)

【国際特許分類】

H 05 K 3/20 (2006.01)

H 05 K 3/00 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/20 Z

H 05 K 3/00 J

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月18日(2010.3.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

三次元的に成型した合成樹脂材から成る樹脂プレート上に、所定形状に打ち抜いた金属箔から成る回路パターンを載置した回路基板において、前記金属箔からビク刃により前記回路パターンを打ち抜くと共に、前記回路パターンを前記ビク刃間に保持して前記樹脂プレート上に運搬し、前記樹脂プレート上に固定することを特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項2】

前記回路パターンは前記ビク刃間に設けた吸着手段により前記ビク刃間に保持することを特徴とする請求項1に記載の回路基板の製造方法。

【請求項3】

前記ビク刃間に空気噴出部を設け、前記ビク刃間に保持した前記回路パターンを前記空気噴出部から噴射した空気により前記樹脂プレート上に載置することを特徴とする請求項1又は2に記載の回路基板の製造方法。

【請求項4】

前記ビク刃間に複数のピン状の押出部を設け、前記ビク刃間に保持した前記回路パターンを前記押出部により押し出して前記樹脂プレート上に載置することを特徴とする請求項1～3の何れか1つの請求項に記載の回路基板の製造方法。